



平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年8月7日

上場会社名 アピックヤマダ株式会社
コード番号 6300 URL <http://www.apicyamada.co.jp/>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 野中正樹
問合せ先責任者 (役職名) 企画部長 (氏名) 小出 篤

TEL 026-275-2111

四半期報告書提出予定日 平成24年8月10日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年3月期第1四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期第1四半期	2,630	2.8	△239	—	△252	—	△253	—
24年3月期第1四半期	2,560	△18.8	△260	—	△243	—	△253	—

(注) 包括利益 25年3月期第1四半期 △203百万円 (—%) 24年3月期第1四半期 △207百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年3月期第1四半期	△20.37	—
24年3月期第1四半期	△20.37	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
25年3月期第1四半期	10,624	4,131	38.9	332.51
24年3月期	10,835	4,335	40.0	348.89

(参考) 自己資本 25年3月期第1四半期 4,131百万円 24年3月期 4,335百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
25年3月期	—	—	—	—	—
25年3月期(予想)	—	0.00	—	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	4,000	△27.7	△470	—	△390	—	△400	—	△32.19
通期	10,000	1.0	△290	—	△110	—	△140	—	△11.26

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(注)詳細は、添付資料P.3「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

25年3月期1Q	12,969,000 株	24年3月期	12,969,000 株
25年3月期1Q	542,446 株	24年3月期	541,296 株
25年3月期1Q	12,426,879 株	24年3月期1Q	12,428,149 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.2「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 継続企業の前提に関する重要事象等	3
4. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 継続企業の前提に関する注記	8
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	8
(5) セグメント情報等	8
(6) 重要な後発事象	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災による景気の落込みから復興需要が顕在化するなど企業の生産活動に改善が見られましたが、電力供給不安や円高の長期化等懸念すべき問題が多く、景気の先行きは不透明な状況が続きました。海外におきましても、タイ国の洪水被害の復旧が進み、経済活動も回復してまいりましたが、欧州の金融不安や米国景気の回復の遅れ、及びこれまで高い経済成長を示してきた新興国、特に中国で成長の鈍化傾向が見られるなど、国内同様、総じて先行きが不安視される状況で推移しました。

当社グループの属する半導体業界では、携帯電話市場に登場したスマートフォンが、2010年代に入りモバイルインターネットユーザーの急速な拡大を誘発し、同市場向けの需要が急拡大しています。また、電力不足が深刻化する中で、“省エネ・創エネ・蓄エネ”の意識が浸透し、パワーエレクトロニクスが急速に拡大する下地が整ってきており、パワー半導体に注目が集まっています。

このような状況の中、当社の省エネ用半導体デバイスや車載用半導体分野への取り組みとして、新規パッケージ開発の推進と強化に取り組んでおります。また、新技術の開発及び新製品の拡販に関しましては、携帯端末機器などに使用される極薄パッケージの成形技術として、トランスファー成形技術と圧縮成形技術(コンプレッション成形技術)のそれぞれの特徴を生かしたトランスファー・コンプレッション・モールド技術(略称：TCM)が量産用の技術及び設備として採用され、これまでのウェハモールド技術や液状樹脂のトランスファー成形技術に加え、用途に応じた技術及び製品のラインナップが充実しました。

当社グループが4月からスタートさせた「中期経営計画」は事業構造改革・生産改革・営業改革の3つの改革(Innovation 3)を推し進め既存の半導体事業の強化と新規事業の拡大を行うものであり、全社一丸となり取り組んでおります。

当第1四半期連結累計期間の売上高は2,630百万円(前年同四半期比2.8%増)、営業損失は239百万円(前年同四半期は営業損失260百万円)、経常損失は252百万円(前年同四半期は経常損失243百万円)、四半期純損失は253百万円(前年同四半期は四半期純損失253百万円)となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

①電子部品組立装置

電子部品組立装置については、全般的には国内外とも半導体メーカーは設備投資には慎重であり引き続き低調に推移しましたが、携帯端末機器向けなど一部では積極的な設備投資の動きが見られ、TCM及びウェハモールド関連などの受注が増加しました。

この結果、売上高は1,774百万円(前年同四半期比45.4%増)、セグメント損失は43百万円(前年同四半期はセグメント損失65百万円)となりました。

②電子部品

電子部品については、LED市場向けが漸増傾向で推移するとともに、一般半導体向けについても回復傾向にありましたが、厳しい価格競争の影響を受けました。また、既報のとおり、タイ国の大規模水害により、リードフレームが主力の連結子会社アピックヤマダ タイランド カンパニー リミテッドが事業閉鎖となったため、前年同四半期比で大幅な売上の減少となりました。

この結果、売上高は729百万円(前年同四半期比35.0%減)、セグメント損失は42百万円(前年同四半期はセグメント損失60百万円)となりました。

③その他

その他につきましては、リード加工金型およびリードフレーム生産用金型の販売を行っておりますが、半導体メーカーは設備投資には慎重となり低調に推移しました。

この結果、売上高は126百万円(前年同四半期比42.0%減)、セグメント利益は4百万円(前年同四半期比81.6%減)となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、10,624百万円(前連結会計年度末は10,835百万円)となり、前連結会計年度末と比較して210百万円減少いたしました。これは主にたな卸資産の減少によるものであります。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における負債合計は、6,492百万円(前連結会計年度末は6,499百万円)となり、前連結会計年度末と比較して6百万円減少いたしました。これは主に支払手形、短期借入金及び長期借入金の減少によるものであります。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は、4,131百万円(前連結会計年度末は4,335百万円)となり、前連結会計年度末と比較して204百万円減少いたしました。これは主に四半期純損失の計上による利益剰余金の減少によるものであります。

なお、これらの要因により、自己資本比率は38.9%(前連結会計年度末は40.0%)となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成24年5月11日公表いたしました連結業績予想から修正を行っておりません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
(減価償却方法の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

この変更による影響額は軽微であります。

3. 継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

4. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,245,611	2,318,675
受取手形及び売掛金	2,320,539	2,351,140
商品及び製品	788,587	712,140
仕掛品	1,125,924	1,032,925
原材料及び貯蔵品	209,165	160,368
その他	179,240	148,012
貸倒引当金	△3,495	△3,729
流動資産合計	6,865,573	6,719,533
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,210,864	1,198,583
機械装置及び運搬具(純額)	610,493	583,442
土地	845,657	853,171
その他(純額)	135,734	127,063
有形固定資産合計	2,802,749	2,762,261
無形固定資産	133,974	119,042
投資その他の資産		
関係会社出資金	560,885	599,096
その他	493,280	444,429
貸倒引当金	△21,389	△19,560
投資その他の資産合計	1,032,776	1,023,964
固定資産合計	3,969,500	3,905,268
資産合計	10,835,074	10,624,801
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,511,309	1,646,987
短期借入金	2,613,500	2,560,000
1年内返済予定の長期借入金	321,308	321,308
未払法人税等	10,064	7,310
賞与引当金	89,133	52,454
製品保証引当金	24,017	22,788
その他	377,503	422,898
流動負債合計	4,946,835	5,033,746
固定負債		
長期借入金	609,592	529,690
退職給付引当金	796,462	789,571
その他	146,235	139,888
固定負債合計	1,552,289	1,459,150
負債合計	6,499,125	6,492,897

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,837,500	5,837,500
利益剰余金	△577,847	△830,957
自己株式	△99,766	△99,910
株主資本合計	5,159,886	4,906,632
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△6,567	△14,799
為替換算調整勘定	△817,368	△759,928
その他の包括利益累計額合計	△823,936	△774,728
純資産合計	4,335,949	4,131,903
負債純資産合計	10,835,074	10,624,801

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)
売上高	2,560,188	2,630,756
売上原価	2,171,797	2,305,754
売上総利益	388,391	325,002
販売費及び一般管理費	648,649	564,139
営業損失(△)	△260,258	△239,137
営業外収益		
受取利息及び配当金	942	856
持分法による投資利益	7,382	—
受取技術料	11,405	—
助成金収入	—	7,329
その他	17,466	16,510
営業外収益合計	37,196	24,697
営業外費用		
支払利息	15,391	18,673
為替差損	2,056	9,032
売上債権売却損	1,643	697
持分法による投資損失	—	5,263
その他	1,641	4,533
営業外費用合計	20,733	38,200
経常損失(△)	△243,794	△252,640
特別利益		
固定資産売却益	—	5
特別利益合計	—	5
税金等調整前四半期純損失(△)	△243,794	△252,634
法人税、住民税及び事業税	14,883	1,310
法人税等調整額	△5,575	△835
法人税等合計	9,308	475
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△253,103	△253,110
四半期純損失(△)	△253,103	△253,110

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△253,103	△253,110
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,822	△8,231
為替換算調整勘定	34,000	24,031
持分法適用会社に対する持分相当額	14,373	33,408
その他の包括利益合計	45,551	49,208
四半期包括利益	△207,551	△203,902
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△207,551	△203,902

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

(セグメント情報)

I 前第1四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注)	合計
	電子部品 組立装置	電子部品	計		
売上高					
外部顧客への売上高	1,220,311	1,121,493	2,341,805	218,383	2,560,188
セグメント間の内部売上高 又は振替高	27,395	—	27,395	81,001	108,396
計	1,247,706	1,121,493	2,369,200	299,384	2,668,585
セグメント利益又はセグメン ト損失(△)	△65,993	△60,599	△126,593	26,626	△99,966

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リード加工金型及びリードフレーム金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	△126,593
「その他」の区分の利益	26,626
セグメント間取引消去	117
全社費用(注)	△160,408
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△260,258

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当する事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間（自平成24年4月1日 至平成24年6月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

	報告セグメント			その他 (注)	合計
	電子部品 組立装置	電子部品	計		
売上高					
外部顧客への売上高	1,774,758	729,314	2,504,073	126,683	2,630,756
セグメント間の内部売上高 又は振替高	10	—	10	14,466	14,477
計	1,774,769	729,314	2,504,083	141,150	2,645,234
セグメント利益又はセグメン ト損失（△）	△43,392	△42,066	△85,459	4,890	△80,568

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リード加工金型及びリードフレーム金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益	金額
報告セグメント計	△85,459
「その他」の区分の利益	4,890
セグメント間取引消去	117
全社費用（注）	△158,686
四半期連結損益計算書の営業損失（△）	△239,137

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当する事項はありません。

（6）重要な後発事象

該当事項はありません。